



新應材股份有限公司

(股票代號：4749)

法人說明會

aemc

2025年11月17日

- 本公司對其現況的期待及預測是屬於前瞻性陳述的範疇，本身具有重大風險及不確定性，而致實際結果可能與前瞻性陳述內容有明顯差異。
- 本公司對於前瞻性陳述不作任何聲明或保證，除非法令另有要求外，本公司亦不因新資訊、未來事件或其他情事變更事由，負有主動更新前瞻性陳述的義務。

- 公司簡介
- 主要產品與市場規模
- 產品開發計畫
- ESG永續實績
- 附錄



使命Mission-建立上下游供應鏈

建立台灣半導體先進製程特化材料自主技術，
並透過合作提升本土特化材料上、下游產業鏈的
全球競爭優勢



願景Vision-擴大黃光微影材料品項及市佔率

持續精進合成、純化、配方和製程技術，
滿足客戶需求以協助提升良率，創造卓越的附加價值，
成為具全球競爭力的創新型特化材料企業

獲頒

台積電2022年
優良卓越供應商
黃光材料開發合作
與量產支援

榮獲

2023年
經濟部國家
產業創新獎

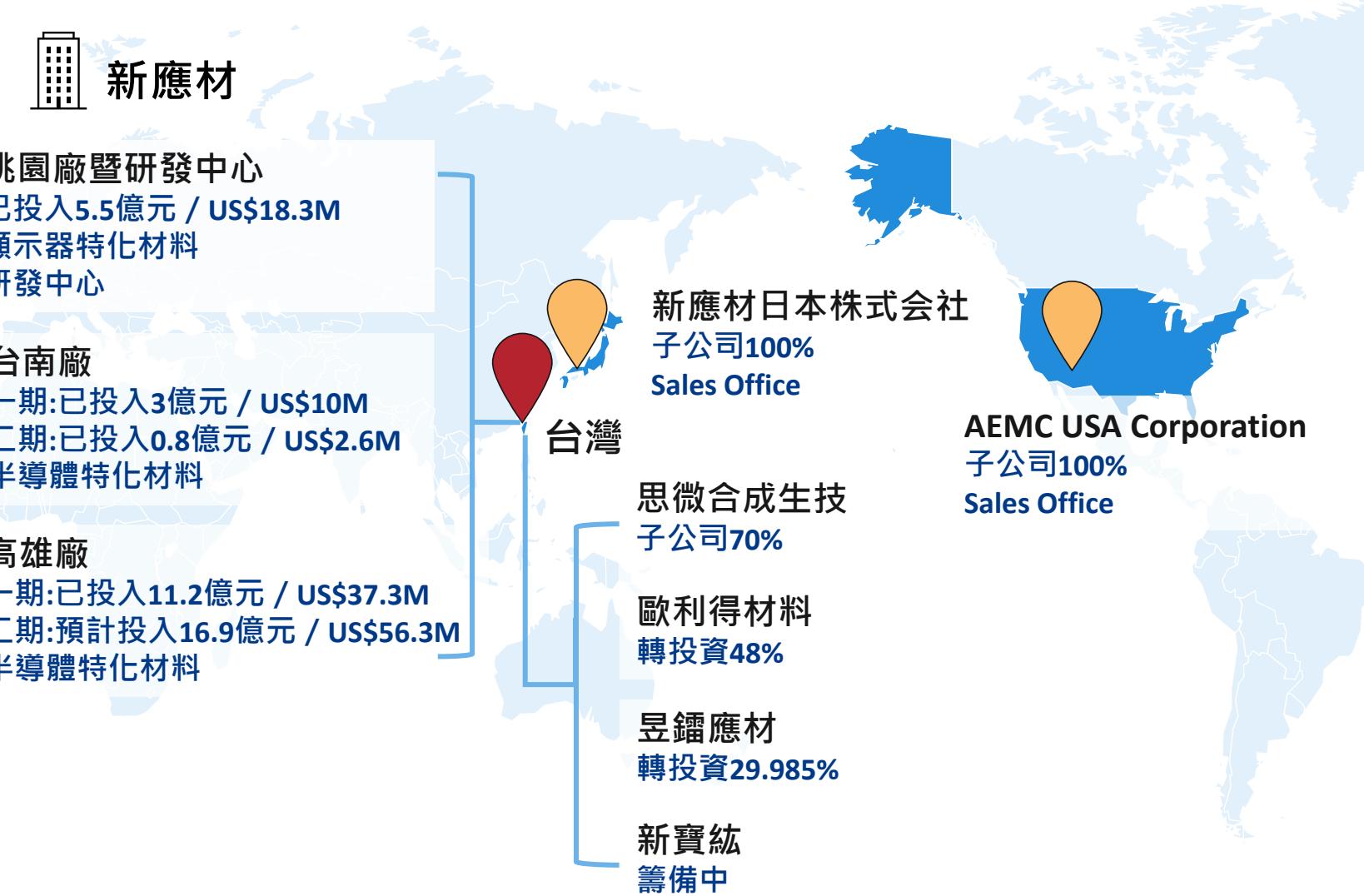
實收資本額
NT\$925,624千元 / US\$30,854K

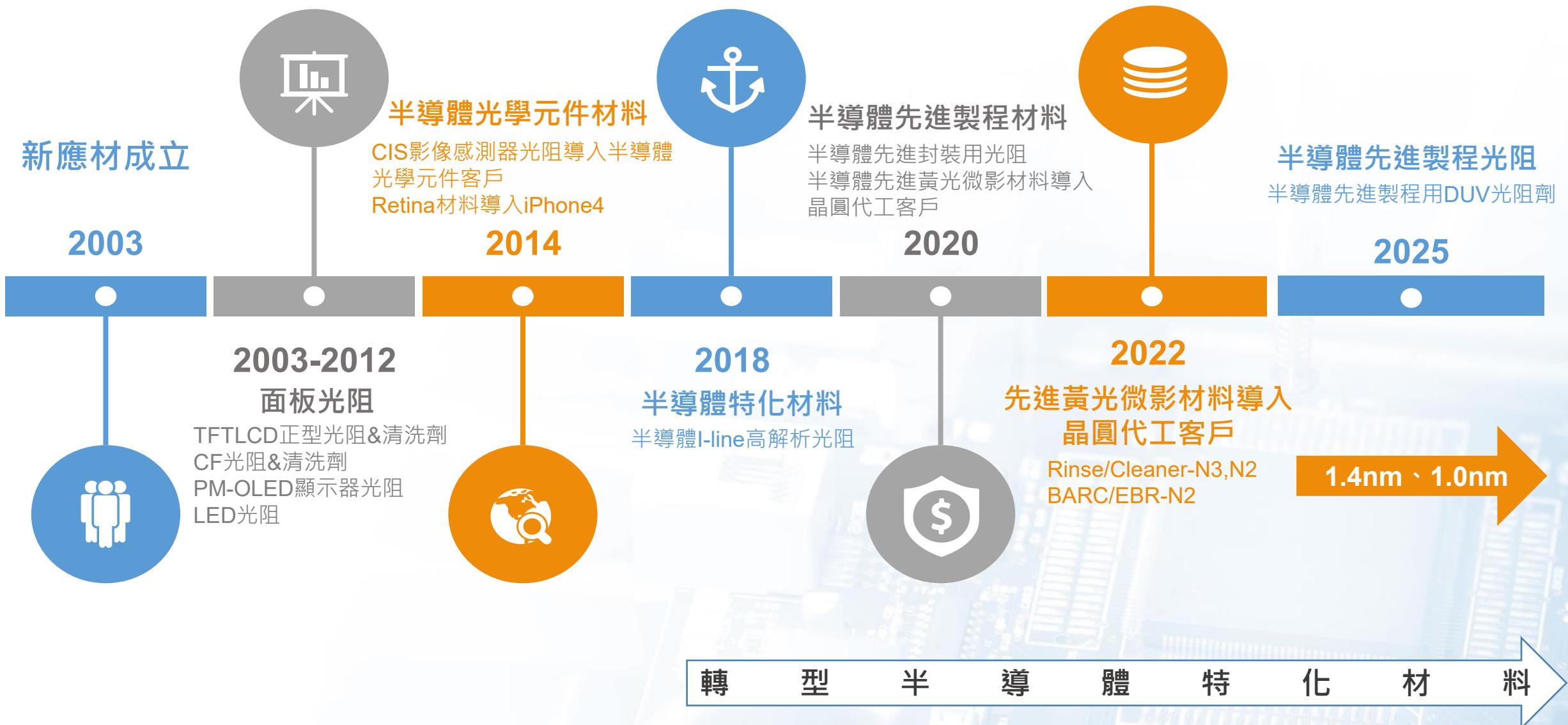
主要產品

- 半導體特化材料
先進製程材料
先進封裝材料
光學元件材料
- 顯示器特化材料
LCD光阻
Micro-LED光阻

員工數

445人(2025.10)
研發人員:130人(2025.10)





- 先進微影製程

表面改質劑(Rinse)

洗邊劑(EBR)

清洗劑(Cleaner)

顯影劑(Developer)

底部抗反射層(BARC)

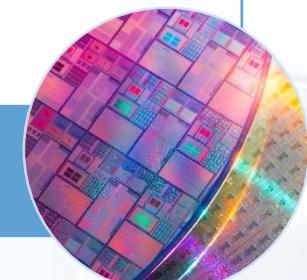
- 先進封裝材料

- 光學元件

影像感測器材料

微型光學元件材料

半導體特化材料



- TFT LCD

TFT 正型光阻

- Micro LED

量子點油墨/光阻劑

灰色/白色阻擋層光阻劑

離型層光阻劑

底部充填膠

低溫光阻劑

高/低折射率材料

顯示器特化材料



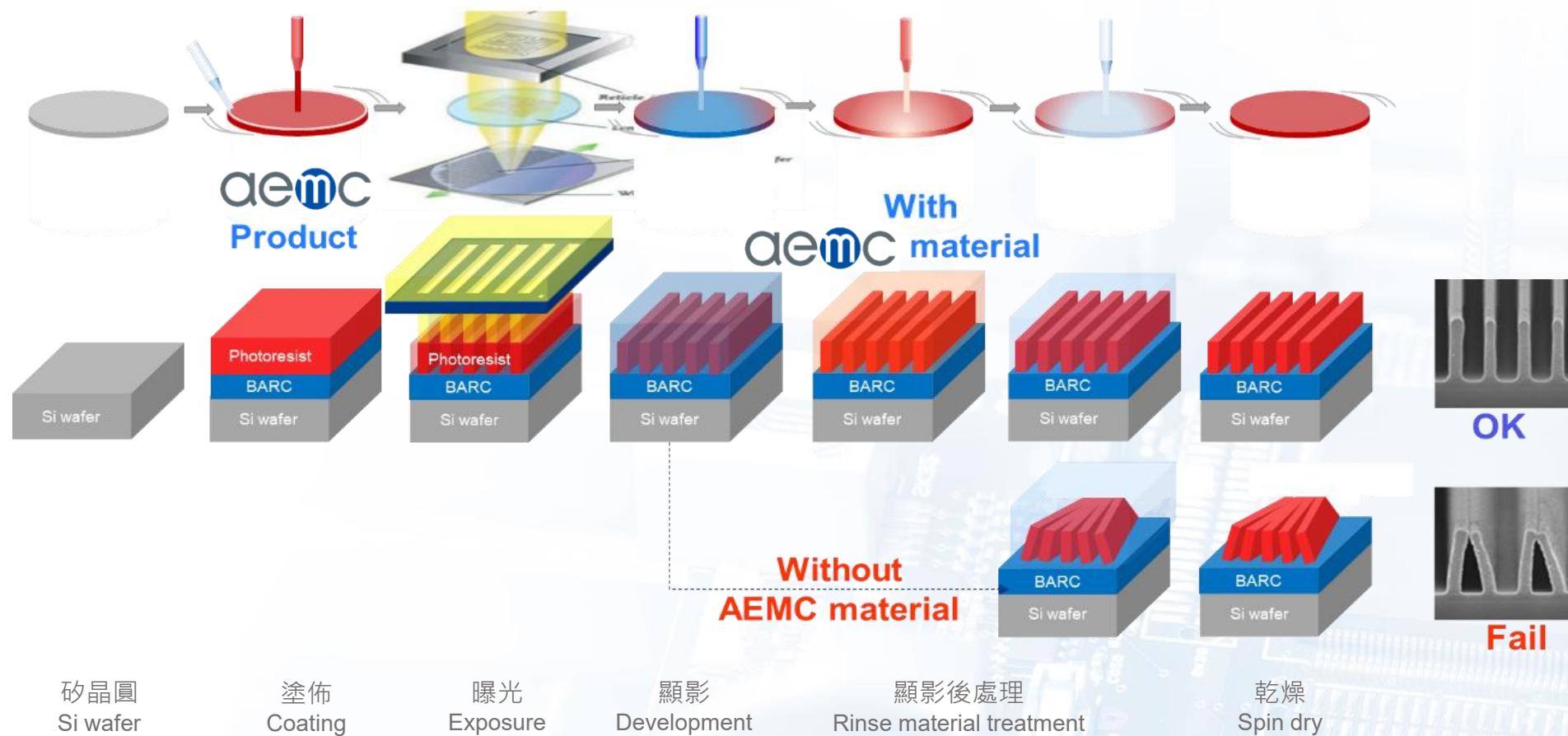
aemc
產品

- 抗反射劑BARC
- 洗邊劑EBR

- 顯影劑
Developer

- 表面改質劑
Rinse Material

- 清洗劑Cleaner
(管路、設備)



效益 Benefits

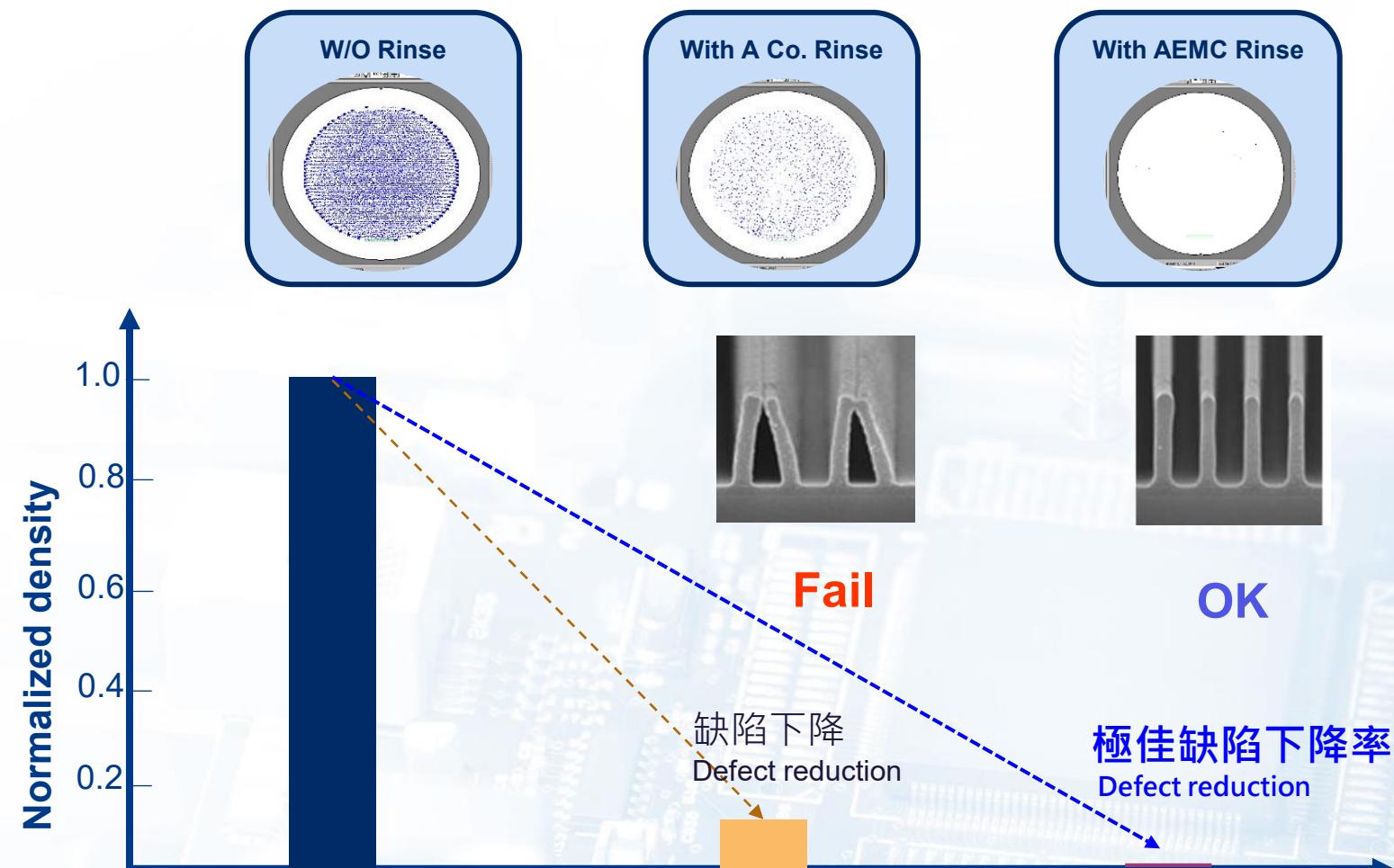
- ✓ 製程簡單 Straightforward process
- ✓ 降低圖案缺陷 Pattern collapse mitigation
- ✓ 降低缺陷 Defect reduction

挹注專業資源，精進供應商研發力

微影製程在半導體製造過程至關重要，是確保晶片品質與穩定性的核心技術之一，因其材料研發及生產技術門檻高，過往主要仰賴進口供料。為提升本土供應鏈研發實力與生產效率，民國108年台積公司資材供應鏈管理處攜手奈米製像技術發展處展開「供應商原物料技術輔導計畫」，針對微影製程材料的「技術開發、品保分析、數據校正、樣品驗證、廠務配置、桶槽改善、擴產規畫」七大環節提供專業指導，不僅有效縮短供應商50%產線建置與產品驗證時間，其材料品質更優於台積公司製程標準、進一步提升良率，全方位強化供應商競爭力，為本土微影製程材料供應鏈發展奠定堅實基礎。

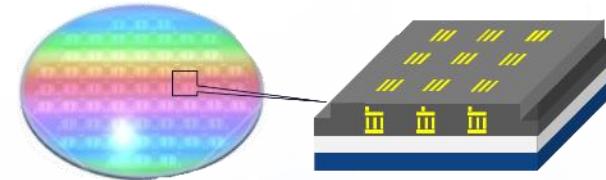


資料來源:晶圓代工客戶ESG永續管理網
<https://esg.tsmc.com/zh-Hant/articles/74>

缺陷對比 Defect comparison**新應材 Rinse材料性能世界No.1**

新應材產品

- ✓ 平坦層光阻劑 Over Coat PR
- ✓ 黏著助劑 Adhesive Promoter
- ✓ 光阻 Photo Resist
- ✓ 微透鏡光阻劑 Microlens PR
- ✓ 微透鏡保護層光阻劑 Microlens Protection PR



鍍膜沉積

塗佈

曝光

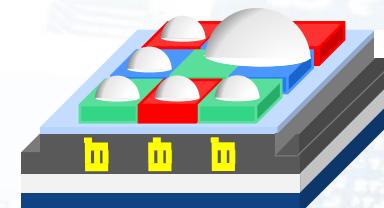
顯影

蝕刻

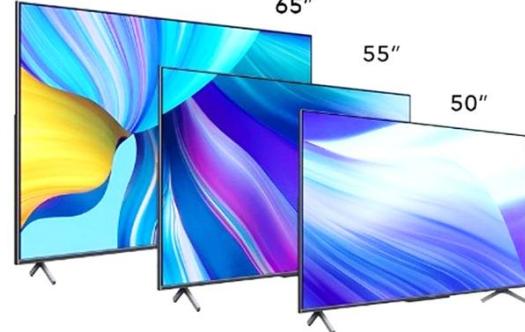
半導體光學元件材料



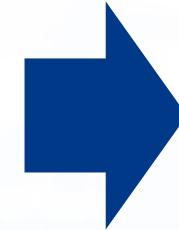
CMOS chip



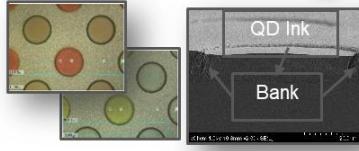
TFT LCD 光阻材料



- TFT LCD光阻



量子點油墨
解析度:30~50μm
色域(NTSC >120%)



量子點光阻劑
解析度 3~5μm
色域(NTSC >120%)

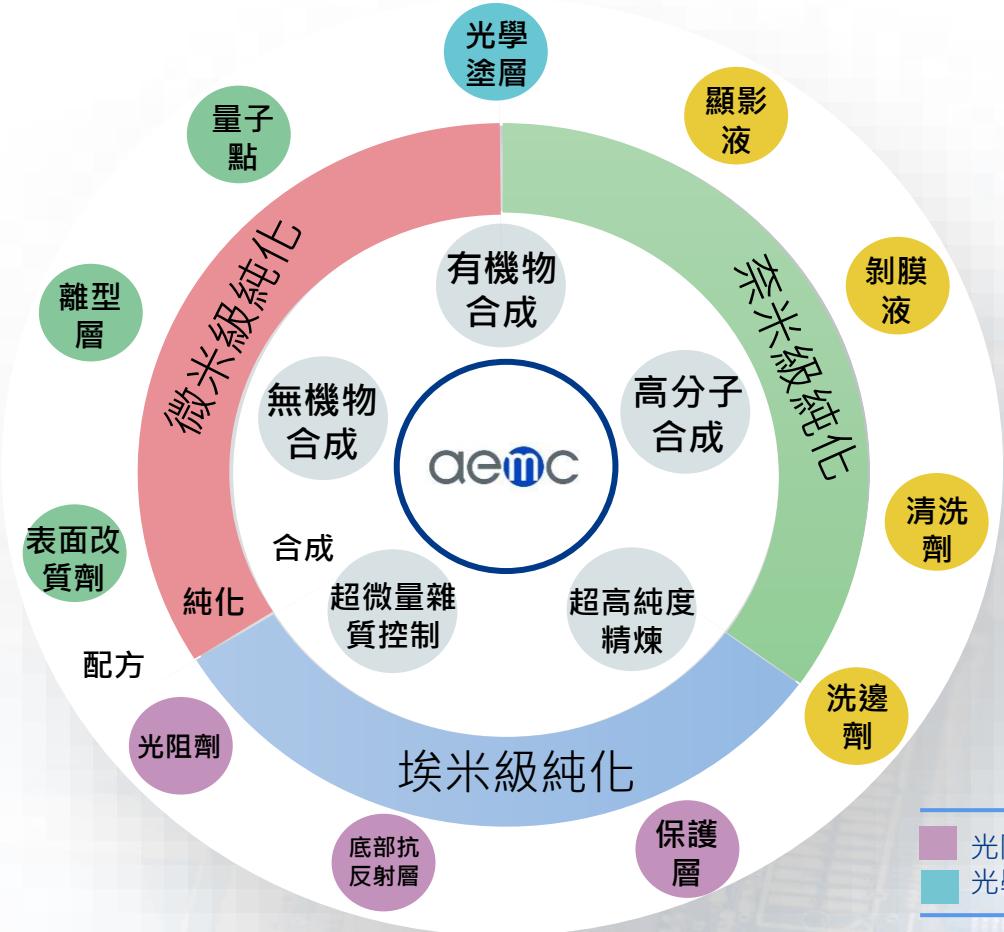


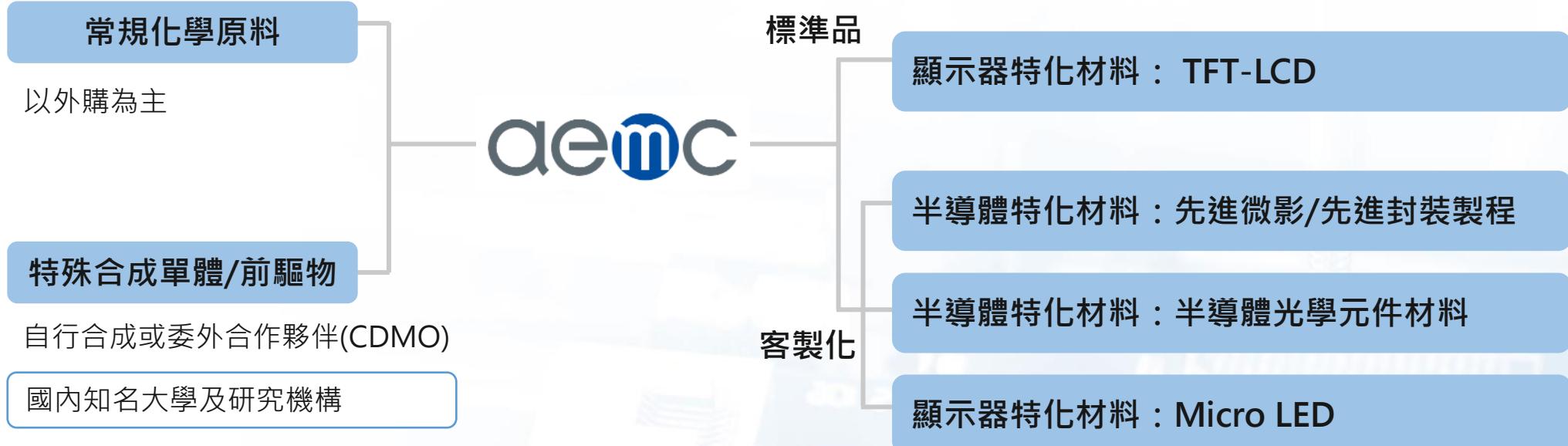
Micro LED QD量子點關鍵材料



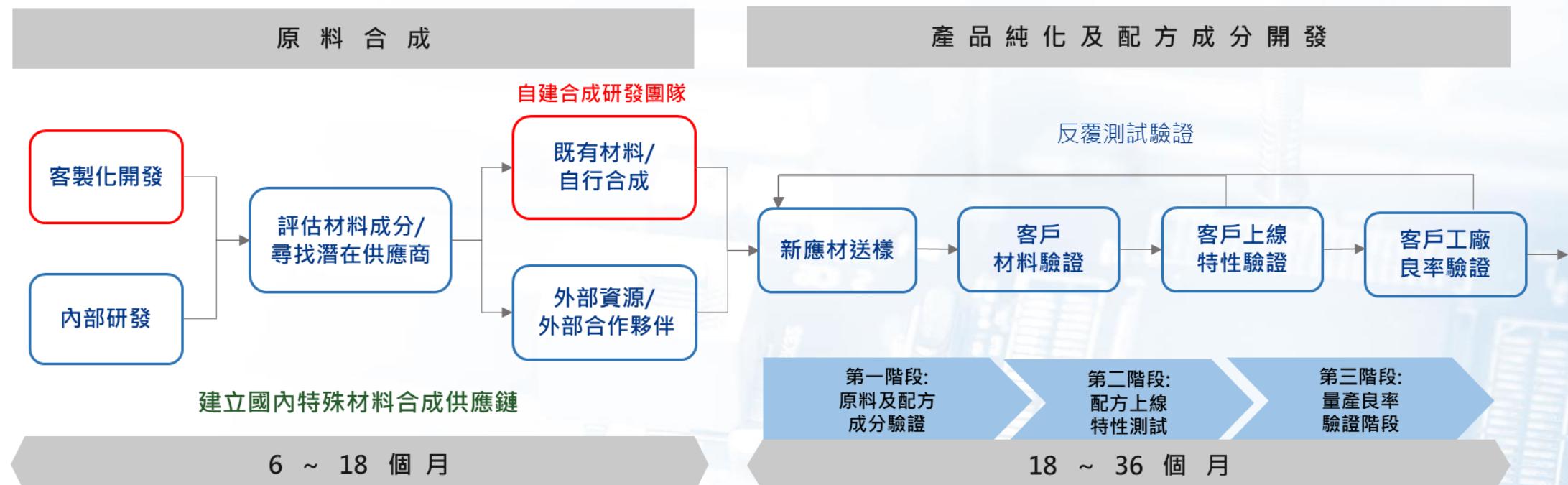
- 量子點油墨/光阻劑
- 灰色/白色阻擋層光阻劑
- 離型層光阻劑
- 底部充填膠
- 低溫光阻劑
- 高/低折射率材料

近20年材料/數千種材料配方資料庫





客製化開發之回應速度及送樣頻率 遠高於國外大廠



優異的品質控管

✓ 品質控管設備與系統:

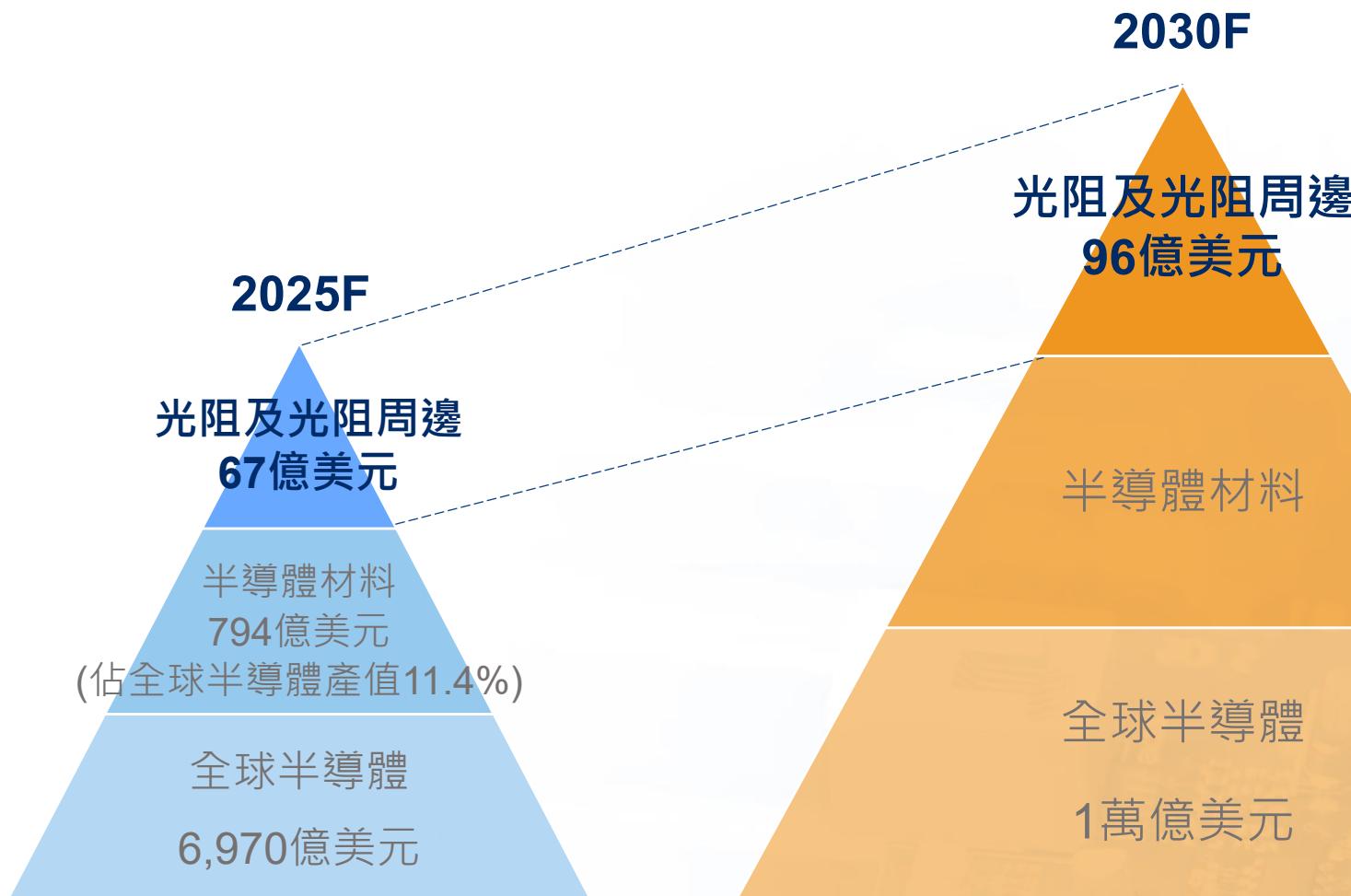
1. 建置與客戶同等級設備
2. 符合半導體最先進製程需求之超微量雜質控管: 由 ppb (10^{-9}) 進化到 ppt (10^{-12})等級
3. 智能品質監控系統: 自動化產品檢測與品質數據整合分析

自主設計的製程技術

產品階段

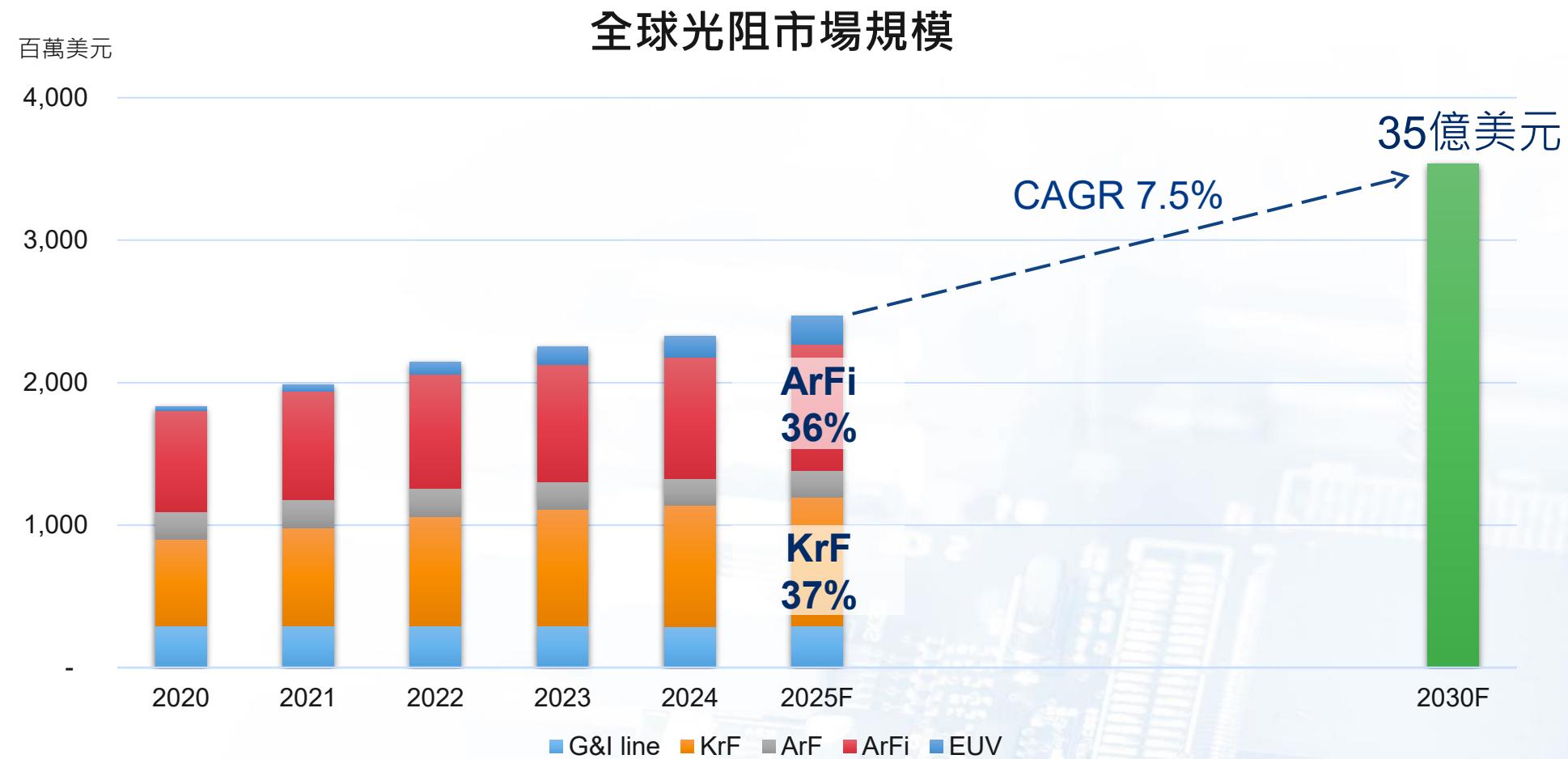
自建產線





aemc 專注之市場

擴大黃光微影材料品項
提升市佔率



資料來源:TECHCET(2021)、WSTS(2024)、Deloitte(2025)、新應材彙整推估

新竹寶山
2座/4座*

台中
1座/4座*

台南沙崙
0座/3座*

高雄
3座/6座*

台灣

美國

亞利桑那
4/3/2nm
3座/6座*

日本

熊本
28/22/16/12/7/6nm
2座/2座*

德國

德勒斯登
28~12nm車用晶片
1座/1座*

* 已動工晶圓廠座數 / 預計總座數

資料來源:經濟日報、Digitimes等媒體報導

2025/10/18 經濟日報

...台積電（2330）中科A14（1.4奈米）先進製程建廠工程動了！台積電昨（17）日正式向中科管理局送件申報開工，中科新廠預計2028年下半年量產，初期投資金額預估將高達490億美元（約新台幣1.5兆元），創造8,000至1萬人工工作機會。...

2025/10/16 Digitimes

台積電透過日本子公司JASM規劃在日本熊本縣興建的第二座晶圓廠，據台積電董事長魏哲家於10月16日的法說會上表示，興建工程已經開始。不過熊本第二座晶圓廠量產的時間，將視客戶需求與市場狀況而定。...

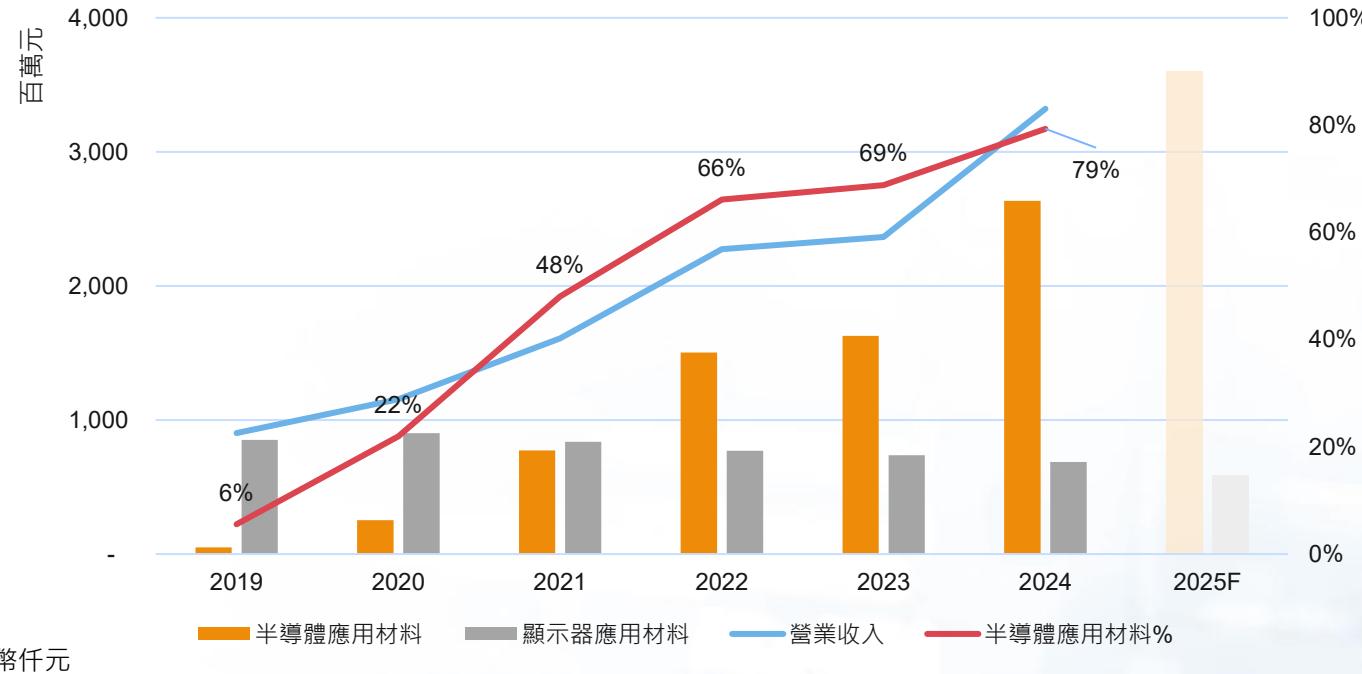
2025/10/7 工商時報

...台積電高雄園區坐落於原中油煉油廠舊址，占地約170公頃，是南台灣最大的半導體投資案。據了解，P1廠確定於今年底量產2奈米晶圓，P2廠已於8月進機，現正進行裝機與調機作業，預定明年第二季量產。P3廠在去年10月取得高雄市府開工核准，P4與P5廠也於今年7月獲準開工，意味五座先進製程廠房全數啟動。...

2025/2/3 經濟日報

...據了解，台積電已向南科管理局提出在台南沙崙設立1.4奈米及1奈米用地需求，這也意謂著六座廠的規畫，初期前三座廠、即P1到P3將作為1.4奈米生產使用，後三座為1奈米。若中科廠能順利交地，中科廠優先列入1.4奈米生產規畫藍圖後，台積電在台南沙崙建廠也可能改為前三座為1奈米，後三座為0.7奈米...

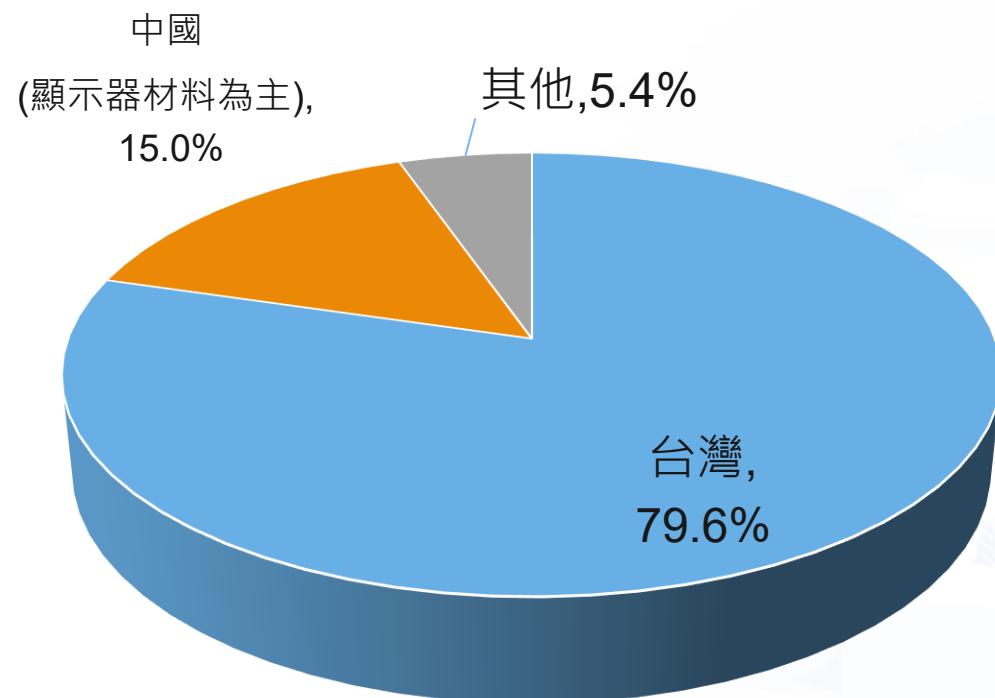
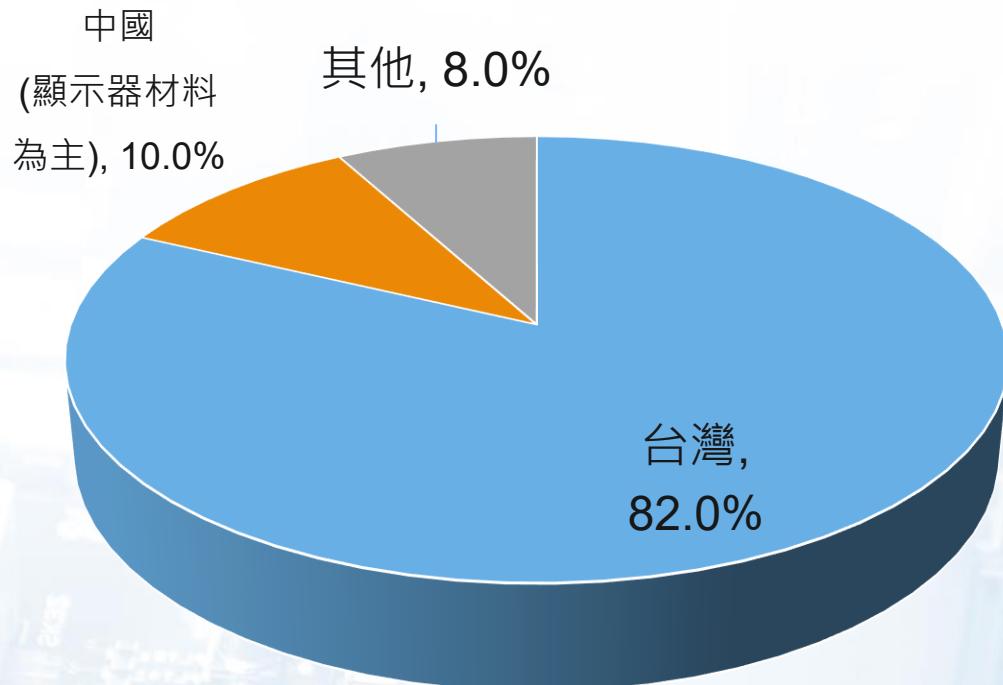
Application Field		Mass Production	Verification	Developing
Semiconductor	Advanced Microlithography Materials	<ul style="list-style-type: none">Rinse Material (表面改質劑)BARC (底部抗反射層)EBR (晶邊清洗劑)Cleaner (清洗劑)	<ul style="list-style-type: none">Rinse Material for next nodeBARC for next nodeEBR for next node	<ul style="list-style-type: none">DUV Photoresist (KrF)Bottom LayerAdvanced BARCProtection Layer
	Advanced Packaging Materials	<ul style="list-style-type: none">NA	<ul style="list-style-type: none">Protection LayerCleanerPhotoresist	<ul style="list-style-type: none">Protection LayerHigh AR PhotoresistLeveling LayerPackaging Glue
	Optical Element Materials	<ul style="list-style-type: none">Photoresists (光阻劑)Flat Layer (平坦層)Color Filter Layer (濾光層)Light-cut Layer (遮光層)	<ul style="list-style-type: none">PhotoresistsStripper	<ul style="list-style-type: none">DUV Photoresist (ArF)Leveling LayerMicrolens Materials
Display	Micro-LED Materials	<ul style="list-style-type: none">QD Ink (量子點油墨)Bank Layer (阻隔層)Flat Layer (平坦層)	<ul style="list-style-type: none">QD inkBlack Glue	<ul style="list-style-type: none">QD Ink for next generation



年度	2020	2021	2022	2023	2024	1Q2025	2Q2025	3Q2025
營業收入	1,155,590	1,609,310	2,274,422	2,364,382	3,321,861	959,316	1,152,698	1,065,504
半導體應用材料	253,662	772,820	1,503,477	1,627,118	2,634,121	787,504	1,025,536	938,531
顯示器應用材料	901,928	836,490	770,945	737,264	687,740	171,811	127,163	126,973
營業毛利	297,287	422,167	723,053	694,252	1,204,394	374,655	533,004	450,418
營業(損)益	(6,442)	52,685	295,186	224,802	586,794	191,380	357,504	259,148
稅前淨利	13,277	132,458	465,957	361,436	828,347	249,870	347,192	336,588
歸屬母公司淨利	13,277	122,346	403,500	318,372	697,538	207,757	284,603	290,131
每股盈餘	0.21	1.62	5.01	3.91	8.50	2.28	3.07	3.13

自2018年轉型半導體材料開發，累計至2024年底資本支出投入已超過**33**億元



2024年**1Q2025~3Q2025**

註:其他銷售區域包含美國、日本、新加坡...等

較法規時程提前完成溫室氣體盤查，
2024年取得第三方查證機構核發聲明書



榮獲重要晶圓代工客戶頒發

「供應商節能減碳輔導專案」感謝狀

員工自發性籌辦、參與
社會公益與環境永續活動



植樹活動



舊鞋救命



4席獨立董事，占比>44%

2席女性董事，占比>22%

2025年發行永續報告書



女性員工平均占比>35% ·
經理級以上之女性主管比例>35%

成立「新應材獎學金」培育材料專才、
成立「新住民子女獎助學金」栽培多元人才、
積極參與「產學合作」，為半導體產業發展恪盡責任。





感謝聆聽

Q&A

aemc

單位:新台幣百萬元	3Q25	2Q25	3Q24	QOQ	YOY
營業收入淨額	1,066	1,153	857	-7.6%	24.4%
營業毛利	450	533	323	-15.5%	39.6%
營業毛利率	42.3%	46.2%	37.7%	-8.6%	12.3%
營業費用	191	176	157	8.7%	21.8%
營業淨利	259	358	166	-27.5%	56.1%
營業淨利率	24.3%	31.0%	19.4%	-21.6%	25.5%
營業外收入及支出	77	-10	27	-851.8%	183.5%
歸屬予母公司業主之本期淨利	290	285	156	1.9%	86.3%
每股盈餘(新台幣元)	3.13	3.07	1.90	2.0%	64.7%

單位:新台幣百萬元

	3Q25		2Q25		3Q24	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金	1,286	12.8%	2,185	21.6%	504	9.9%
應收帳款	552	5.5%	523	5.2%	484	9.5%
不動產、廠房及設備	3,120	31.0%	3,017	29.8%	2,497	48.9%
資產總計	10,071	100.0%	10,123	100.0%	5,107	100.0%
流動負債	1,018	10.1%	1,367	13.5%	1,158	22.7%
長期借款	-	0.0%	-	0.0%	1,036	20.3%
負債總計	1,172	11.6%	1,525	15.1%	2,339	45.8%
股東權益總計	8,899	88.4%	8,588	84.8%	2,768	54.2%
重要財務指標						
流動比率	606%		451%		168%	
負債比率	12%		15%		46%	
每股淨值(新台幣元)	95.96		92.61		33.69	

單位:新台幣百萬元	3Q25	2Q25	3Q24
期初現金	2,569	2,769	477
營運活動之現金流入	158	450	283
折舊及攤銷費用	224	63	59
資本支出	(116)	(128)	(362)
長期借款	(974)	(376)	204
期末現金	1,778	2,569	505
自由現金流量	43	322	(78)

註:自由現金流量 = 營運活動之現金流入 - 資本支出